

SEMIKRON

innovation + service

IGBT

提升标准，挑战新极限

SEMITRANS[®] 10 DPD

高达2MW



由代理商创意电子为您提供技术支持



創意電子有限公司

Weltronics Component Limited

www.weltronics.com

SEMITRANS[®] 10 DPD

SEMITRANS[®] 10 DPD - 高达2MW

SEMITRANS 10 DPD是一种稳健的标准兼容封装，配备铜底板和螺丝端子，凭借全新的芯片直压(DPD)技术将额定输出电流提升至1800A。出色的开关特性确保低损耗，结合超低热阻(Rth)实现低于150°C的工作结温(Tjop)，输出功率比标准焊接封装高出30%，赛米控独有的DPD母线理念保留了单一交流端子设计，可从现有功率组件设计直接升级。

产品优势

- 稳健的工业标准兼容封装
- 芯片直压(DPD)技术
- 优化的低杂散电感设计，确保在高直流母线电压下安全运行
- 独一无二的低损耗开关性能

产品范围

SEMITRANS 10 DPD提供工业标准封装形式的1700V / 1800A半桥拓扑结构。

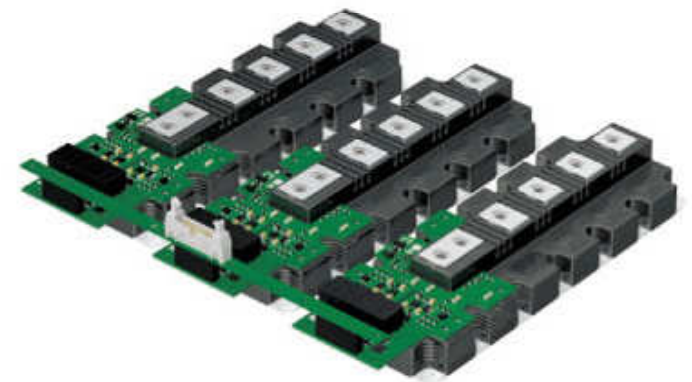
应用

这种基于DPD的全新封装可用于广泛的应用，如风能和太阳能发电、工业驱动器以及牵引应用，它们都要求长使用寿命和稳健性，同时还要保持灵活性和扩展能力。

对称并联结构，输出功率更大

SEMITRANS 10 DPD和SKYPER Prime经过优化设计，可提供卓越的性能、丰富的特性以及先进的并联结构。

- SKYPER Prime驱动的数字信号处理确保在整个温度范围内具有稳定的开关和误差特性
- 稳定的正负门极电压，实现对称分流
- 将误差、传感和开关信号直接并联
- 通过集中式信号分配实现对称门极控制
- 采用板对板连接解决方案，无需昂贵的电缆和连接器组件



关键特性

- 完全兼容工业标准
- 额定电流1800A
- 集成门极电阻
- 高隔离电压
- 芯片直压技术
- 更强的开关性能
- 集成温度传感器
- 采用DBC技术的隔离铜底板

提升标准，挑战新极限

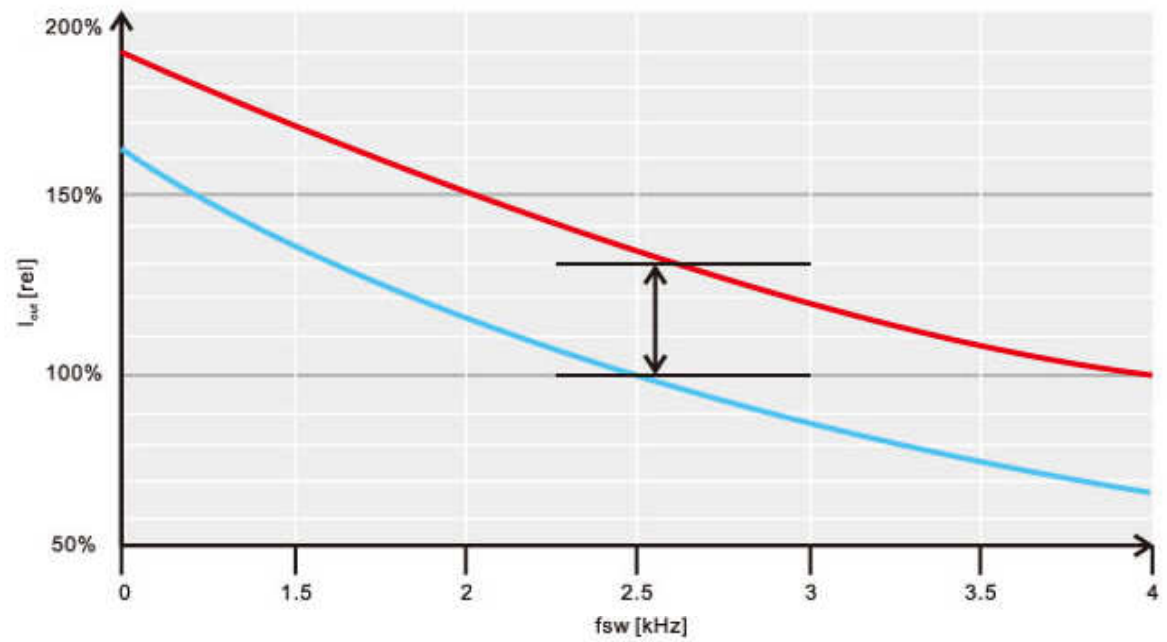
创新的封装设计

- 使用全新芯片直压技术，实现低热阻
- 与焊接和铝线键合技术相比，功率循环可靠性提升约10倍



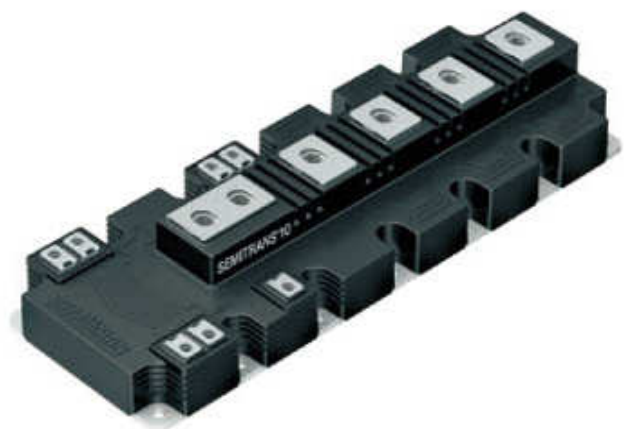
低温条件下的输出功率更大

- 输出功率比采用相同芯片技术的标准焊接模块高30%
- 得益于优化的内部低杂散电感门极布线和 IGBT 并联结构，开关性能显著提升



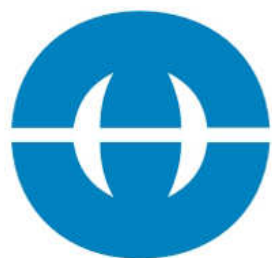
可升级的封装设计

- 与标准封装采用同样的封装外形
- 带单一相交流端子的高性能内部母线



SEMITRANS[®] 10 DPD 产品系列

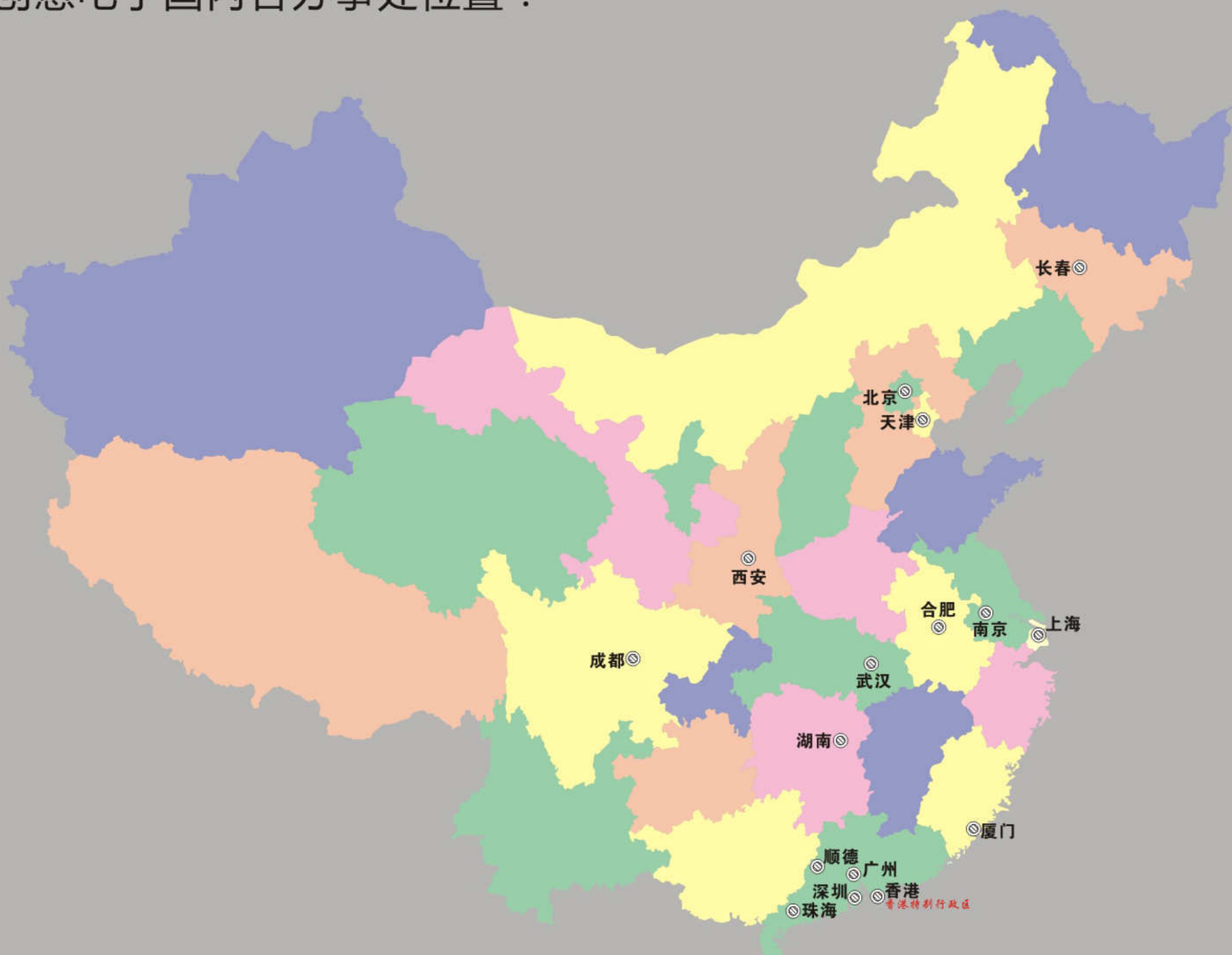
型号	V _{cesin} V	I _{nomin} A	拓扑结构
SKM1800GB17E4DPD	1700	1800	GB



創意電子有限公司

Weltronics Component Limited

创意电子国内各办事处位置：



办事处联系方式：

深圳办事处
电话：(755) 83480330
传真：(755) 83480105

上海办事处
电话：(021)60952881
传真：(021)60952882

广州办事处
电话：(020)83511853
传真：(020)83511491

北京办事处
电话：(010)62982798
传真：(010)62980880

资料索取: market@weltronics.com

